

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成26年 2月 4日
【会社名】	パナソニック株式会社
【英訳名】	Panasonic Corporation
【代表者の役職氏名】	取締役社長 津賀 一宏
【本店の所在の場所】	大阪府門真市大字門真1006番地
【電話番号】	大阪(06)6908-1121
【事務連絡者氏名】	経理グループ グループマネージャー 井垣 誠一郎
【最寄りの連絡場所】	東京都港区東新橋一丁目5番1号(パナソニック東京汐留ビル) パナソニック株式会社 渉外本部
【電話番号】	東京(03)3437-1121
【事務連絡者氏名】	経理グループ グループマネージャー 恩田 幸敏
【縦覧に供する場所】	パナソニック株式会社 渉外本部 (東京都港区東新橋一丁目5番1号(パナソニック東京汐留ビル)) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) 株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目8番20号)

## 1【提出理由】

当社は、平成26年2月4日の取締役会にて、平成26年6月1日（予定）を効力発生日として、当社のセミコンダクター事業部の半導体等の開発・製造・販売に関する事業を、当社が3月中に設立予定の新会社に吸収分割によって承継させること(以下、「本吸収分割」)を決議したので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第7号の規定により、本臨時報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

### (1) 本吸収分割の相手会社についての事項

#### イ 商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

商号	パナソニック セミコンダクター ソリューションズ株式会社（予定）
本店の所在地	京都府長岡京市神足焼町1番地（予定）
代表者の氏名	取締役社長 藤本 佳司（予定）
資本金の額	400百万円（予定）
純資産の額	現時点では確定していません。
総資産の額	現時点では確定していません。
事業の内容	半導体事業および関連部品の開発、製造、販売（予定）

ロ 最近3年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益  
 本年3月に設立予定のため、該当事項はありません。

ハ 大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合  
 パナソニック株式会社 100.00%（予定）

#### ニ 当社との間の資本関係、人的関係、取引関係

資本関係	当社の100%子会社として設立される予定であります。
人的関係	当社の従業員が、吸収分割承継会社の役員をする予定です。
取引関係	事業を開始していないため、当社との取引関係はありません。

### (2) 本吸収分割の目的

当社の半導体事業は、これまで、AV市場から車載・産業市場へのシフトや、当社の強みである低消費電力技術、画像処理技術、化合物技術を活かした商品ラインアップ、ソリューションの展開を図るなど、事業構造転換を含む様々な施策を推進してきました。

これらに加え、商品開発・マーケティングを基軸とした事業一元化によるソリューション力の強化およびアセットライト化による事業リスクの低減を図り、半導体事業の競争力をさらに高めるため、当社は本吸収分割を実施することを決定しました。

### (3) 本吸収分割の方法、割当ての内容、その他本吸収分割の内容

#### イ 本吸収分割の方法

当社を吸収分割会社とし、パナソニック セミコンダクター ソリューションズ株式会社を吸収分割承継会社とする吸収分割です。

#### ロ 本吸収分割に係る割当ての内容

本吸収分割に際して、吸収分割承継会社は当社に対して対価の交付を行わない予定です。

#### ハ その他本吸収分割の内容等

本吸収分割の日程

平成26年3月27日(予定) 分割契約書承認取締役会、分割契約書締結

平成26年6月1日(予定) 効力発生日

(注)本吸収分割は、当社においては会社法第784条第3項に定める簡易吸収分割であり、パナソニック  
セミコンダクター ソリューションズ株式会社においては会社法第796条第1項に定める略式吸収分  
割であるため、それぞれの吸収分割契約承認のための株主総会は行いません。

分割する部門の事業内容

半導体等の開発・製造・販売

本吸収分割により増減する資本金

本吸収分割による当社の資本金の増減はありません。

その他の吸収分割契約の内容

吸収分割契約は、平成26年3月に締結される予定です。

- (5) 本吸収分割の後の吸収分割承継会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

商号	パナソニック セミコンダクター ソリューションズ株式会社(予定)
本店の所在地	京都府長岡京市神足焼町1番地(予定)
代表者の氏名	取締役社長 藤本 佳司(予定)
資本金の額	400百万円(予定)
純資産の額	現時点では確定していません。
総資産の額	現時点では確定していません。
事業の内容	半導体事業および関連部品の開発、製造、販売(予定)

以 上